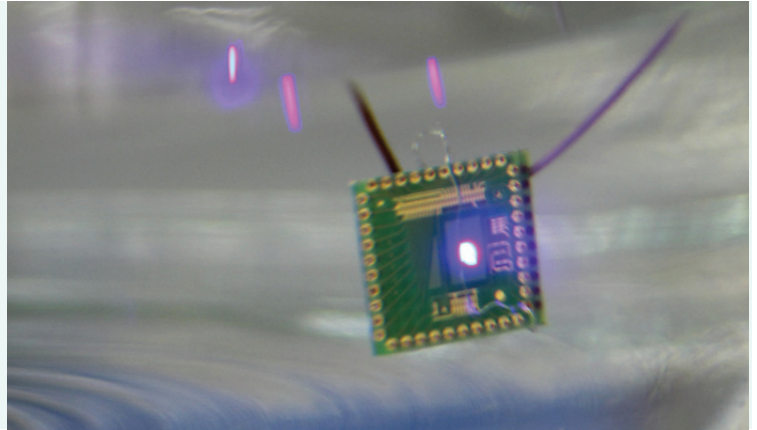
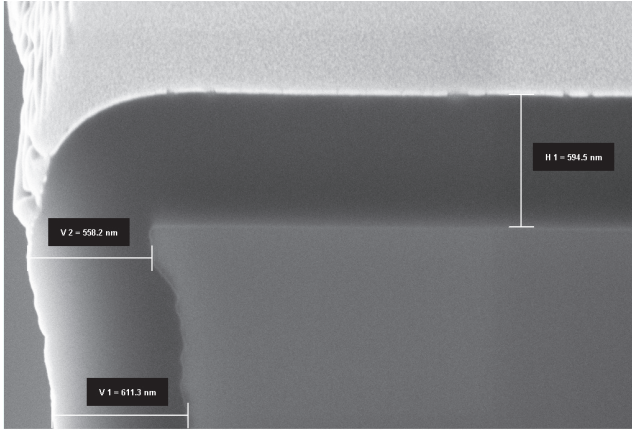


3次元コンフォーマルパリレン[®]蒸着を用いた薄膜封止



お問い合わせ

フラウンホーファー研究機構
エレクトロ・ナノシステム (ENAS)
Technologie-Campus 3
09126 Chemnitz | Germany

担当者

Dr. Maik Wiemer
電話番号: +49 371 45001-233
電子メール:
maik.wiemer@enas.fraunhofer.de

Dr. Mario Baum
電話番号: +49 371 45001-261
電子メール:
mario.baum@enas.fraunhofer.de

図:
高湿度環境で使用するためにパリレンでコーティングしたPCB上のLED

写真提供:
フラウンホーファー-ENAS
このデータシートに含まれる全ての情報は、初期段階のものであり、変更されることがあります。また、ここに記載のシステム、材料およびプロセスは、市販の製品ではありません。

3次元コンフォーマルパリレンコーティングは、多種多様な用途に適した極薄の非多孔性/ピンホールフリーポリマーコーティングであり、高価値の表面処理特性を示します。

特長:

優れた防湿・化学的・誘電バリア
疎水性
光透過性
化学的不活性
温度安定性
ドライフィルム潤滑性
生体適合性

アプリケーション:

電子機器(回路基板の誘電体コーティング、MEMSパッケージ、有機エレクトロニクス保護コーティング)
医療(埋込型/非埋込型機器の生体適合性封止コーティング)
自動車(センサ/電子回路の保護コーティング)
微小機械システム/センサ
半導体産業
解析
バリア層(フィルタ、膜など)

化学産業(接着剤、塗料、ゴム)
摩耗/腐食防止
ボンディング

パリレンCVDプロセス(ゴーラムプロセス):

常温での蒸着
d > 0.2 μmのピンホールフリー
均一な層厚さ
自己反応
終了処理が不要
溶媒や触媒が不要
真空中、550°C以上で100%のモノマー収率([2.2]p-シクロファンを使用)
副生成物なし

フラウンホーファー-ENASにおけるパリレン蒸着:

Plasma Parylene LC 300 RW
チャンバ寸法: 350 mm x 350 mm (直径 x 高さ、回転テーブルを含む)
処理圧力: 2~5 Pa
プラズマ処理: アルゴン、酸素
その他の表面処理: シラン処理
クリーンルーム環境内に設置された設備
C、F、およびその他のタイプのパリレンの蒸着
各種技術によるパターンニング